

本院「亞奈米金貼紙以及其抑制內毒素誘發敗血症之方法」公開徵求技術移轉廠商

公告日期：109 年 7 月 27 日

一、主旨：

本院「亞奈米金貼紙以及其抑制內毒素誘發敗血症之方法」公開徵求技術移轉廠商，進行候選藥物發展。

二、授權技術：

惡性傷口是傷口治療產品的缺口，本發明提供一種高表面比黏著層的金量子點，可減低因細菌死亡後所釋放的活性脂多醣反覆刺激患部造成嚴重發炎，導致傷口無法癒合，此一發明也保留必要的發炎反應，使傷口可由發炎期走向重塑期，並且此特殊金量子點，具有幫助刺激修護傷口的膠原蛋白分泌及規則性地排列，提高傷口癒合的機率。

三、廠商資格：

須具備下列條件者

1. 依法登記且無違法紀錄。
2. 具有相關技術開發經驗與能力者佳。
3. 具國際合作經驗及臨床試驗經驗者佳。
4. 願意長期投入研發資金者佳。

四、報名方式：

符合上述資格且有意願者，請填妥「技術移轉企劃書」(格式如附件一)之相關資料〔內含公司簡介及可闡明上述條件之資料〕，並標明廠商名稱和地址、聯絡人電話與電子郵件等資料，於民國 109 年 8 月 10 日(星期一)前以郵寄正本並搭配傳真或電子郵件方式，送達國家衛生研究院技轉及育成中心 梁華軒先生收(地址：「苗栗縣 35053 竹南鎮科研路 35 號行政大樓 3 樓 技轉及育成中心」，FAX: (037)583-667，E-mail：huahsuan@nhri.edu.tw)。

五、其他：

1. 本院保有隨時修改及終止本公告之權利。
2. 詳細案件狀況請洽詢承辦人。

附檔

附件一：技轉公告電子檔：「亞奈米金貼紙以及其抑制內毒素誘發敗血症之方法」徵求技術移轉廠商

附件二：技術移轉企劃書